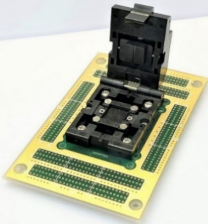
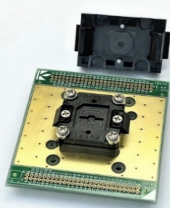


GS シリーズ IC ソケット 一覧

 KASASAKU ELECTRONICS CO.,LTD.					
製品名		001G	002G	003G	004G
ソケット外形寸法		48mm×36mm	41mm×31mm	19.3mm×19.3mm	26.5mm×26.5mm
IC押さえ機構		クラムシェルタイプ	クラムシェルタイプ	蓋分離タイプ	クラムシェルタイプ
特長		外形がやや大きめに設計されているため、安定した保持力や高い作業性の確保が可能です。	汎用性が高く信頼性と使いやすさを兼ね備えており、開発・検査・量産などあらゆる工程で使用が可能です。	蓋を分離式にすることでソケット外形を最も小さくでき、省スペースでの実装が可能です。	クラムシェルタイプで外形が最も小さく、省スペースでの実装が可能です。
実装できるICの最大外形寸法		最大寸法 10mm × 10mm			
対応ICパッケージ		QFP、QFN、BGA、LGA、SOT、SOP、SON、CSP			
GS	対応ピッチ	0.4mmピッチ用 0.5mmピッチ用			
	対応ピン数 (グリッド)	0.4mmピッチ : 324ピン (18×18) 0.5mmピッチ : 361ピン (19×19) のグリッドに準じた範囲であれば、自由な位置にピンを配置することが可能です。			
GH	対応ピッチ	0.25mmピッチ～ ※不等、自由なピン配置が可能です。			
	対応ピン数	10mm×10mm以内 のエリアであれば、自由な位置にピンを配置することが可能です。			
コンタクトピン		スプリングプローブピン			
耐熱温度		- 55℃～ +180℃			
納期(受注後)*1	GS	最短実働 3日～			
	GH	最短実働 5日～			

*1.仕様と数量により変動がございます。